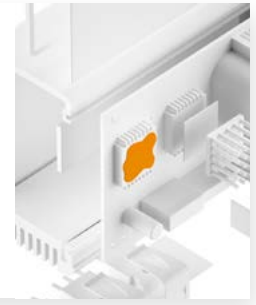


dispensierbar

TGL-X-SI ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfähiger, hochviskoser und dispensierbarer Form-in-Place Gap-Filler mit dem sich gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Der fertige Compound erfordert keinen zusätzlichen Vernetzungsprozess. Durch die Formulierung und Füllung des Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine extrem hohe thermische Leitfähigkeit. Bei Aufbringung des dispensierbaren, viskoplastischen Materials wird ein optimaler thermischer Kontakt ohne Druckaufbringung erzielt. Durch seinen Einsatz wird der thermische Gesamtübergangswiderstand minimiert.

**EIGENSCHAFTEN**

- Dispensierbar
- Fast drucklose Aufbringung durch Viskoplastizität
- Wärmeleitfähigkeit: 6,5 W/mK
- Kein zusätzlicher Vernetzungsprozess

**LIEFERFORMEN**

- Kartuschen 50 ml, 300 ml, 5 kg
- Auf Anfrage

**ANWENDUNGSBEISPIELE**

Thermische Anbindung von z.B.

- SMD Bauteilen
- Through-hole Vias
- RDRAM Speicherbausteine
- Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs

z.B. in Automotiveanwendungen / Notebooks / Medizintechnik / Industriecomputer / 5G Telekommunikationsausrüstung

EIGENSCHAFT	EINHEIT	TGL-X-SI
<b>MATERIAL</b>		
		Keramik gefüllter Silikoncompound
Farbe		Orange
Dichte	g/cm <sup>3</sup>	3,4
Flußrate	g/s g/min	≥ 30 <sup>1</sup> 3 – 4 <sup>2</sup>
Penetration	mm	170
Haltbarkeit (ab Herstellungsdatum, ungeöffnet, trocken gelagert @ < 40°C)	Monate	6
Entflammbarkeit (Äquivalent)	UL 94	V0
RoHS Konformität	2015 / 863 / EU	Ja
<b>THERMISCH</b>		
Thermische Leitfähigkeit <sup>3</sup>	W/mK	6,5
Betriebstemperaturbereich	°C	- 40 bis + 150
<b>ELEKTRISCH</b>		
Durchschlagsfestigkeit <sup>4</sup>	kV / mm	≥ 4,5
Durchgangswiderstand	Ohm - cm	1,0 x 10 <sup>14</sup>

Prüfmethode in Anlehnung an: <sup>1</sup> ISO 9048, <sup>2</sup> 50 cc / 14# @ 0.42 MPa, <sup>3</sup> ASTM D 5470, <sup>4</sup> ASTM D 149. Angaben unverbindlich, technische Änderungen vorbehalten. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Daten und Informationen.